



kingston.com/epop

ePoP

Memória Embarcada PoP (Package-on-Package) para "wearables"

A ePoP da Kingston oferece um componente padrão JEDEC altamente integrado que combina armazenamento (Embedded MultiMedia Card) eMMC e (Low-Power Double Data Rate) LPDDR DRAM dentro de uma solução (Package-on-Package) PoP. A ePoP é montada diretamente no topo de um (System-on-a-Chip) SoC host compatível, que reduz espaço do (Printed Circuit Board) PCB e garante um desempenho excelente. A ePoP é uma solução ideal para aplicações de espaço restrito como "wearables".

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

- Ao montar diretamente no topo de um SoC host, a ePoP fornece a solução ideal para aplicações de tamanho pequeno como os “wearables”.
- Firmware de armazenamento otimizado e DRAM de baixa energia reduz o consumo de energia enquanto entrega o alto desempenho necessário para aplicações “wearable” à bateria.
- Simplifica o design do sistema, reduz o tempo para o mercado e encurta o ciclo de qualificação.
- Configurações de firmware múltiplas disponíveis para melhor se adequar às exigências de sua aplicação em relação ao desempenho, energia e vida útil.

SEGMENTOS DE MERCADO



IoT



Wearables



Dispositivos de Realidade Aumentada (RA) / Realidade Virtual (RV)

EPOP CÓDIGO DO PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES

ePoP com base em LPDDR4x

Código do Produto	Capacidade		Descrição		Embalagem (mm)	FBGA	Temperatura de operação
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
64EP16-M4MTB9W	64	16	5,1	LPDDR4x	8x9.5x0.6	144	-25°C a +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5,1	LPDDR4x	8x9.5x0.65	144	-25°C a +85°C

ePoP com base em LPDDR5x

Código do Produto	Capacidade		Descrição		Embalagem (mm)	FBGA	Temperatura de operação
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
64EP16-M5ATB9W	64	16	5,1	LPDDR5x	8x9.5x0.58	201	-25°C a +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9.5x0.65	201	-25°C a +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9.5x0.7	201	-25°C a +85°C

